

# TELSONIC 研发适用于包装行业的阀门 供料机

2017 年 2 月



设备可以在灵活的咖啡包装薄膜上焊接排气阀

TELSONIC AG 为包装行业新研发了一款超声波阀门供料机，通过意大利不同领域客户测试后获得认可。可立即进行销售。模块用于将市场通用的香味保护或排气阀门焊接在灵活的包装薄膜上，为了便于排气，此时通过焊头中央的机械粘刀稍微挑破阀门和薄膜之间的薄膜。这样可以在一个刀具以及一个紧凑型工位中完成两个必须的工作步骤。通过简单的接口（4 个螺栓）可非常方便的集成到包装任务中。

编辑：Jochen Branscheid，意大利和巴西销售经理